

目次

1章	イントロダクション	1
	L. J. A. Heitz-Mayfield、U. Brägger / (訳) 勝山英明	
2章	文献レビュー	3
	L. J. A. Heitz-Mayfield、U. Brägger / (訳) 三田 稔、塩田 真	
2.1	第4回および第5回 ITI コンセンサス会議から得られた声明と推奨事項	4
2.1.1	第4回 ITI コンセンサス会議議事録(2008年)	4
2.1.2	第5回 ITI コンセンサス会議議事録(2013年)	5
2.2	文献レビュー：生物学的合併症	10
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 三田 稔、塩田 真	
2.3	文献レビュー：ハードウェア関連合併症と失敗	12
	U. Brägger / (訳) 三田 稔、塩田 真	
2.3.1	機械的技術的リスク	12
2.3.2	合併症と失敗の頻度に対する改良されたコンポーネントの影響	12
2.3.3	セメント固定式およびスクリュー固定式の補綴装置の合併症と失敗	13
2.3.4	メタルおよびセラミックアバットメントの合併症率と失敗率	14
2.3.5	最先端のCAD/CAM 支援によるインプラント支持補綴装置製作	14
2.3.6	オーバーデンチャー	14
2.3.7	システムティックレビューより導かれた補綴装置の残存率	15
3章	病因とリスクファクター：生物学的合併症	17
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 山本麻衣子、塩田 真	
3.1	インプラント周囲感染症	18
3.1.1	インプラント周囲のバイオフィルム	20
3.1.2	インプラント周囲感染症のリスクファクター	21
3.1.3	生物学的合併症として現れるハードウェア関連合併症	24
3.2	プラークに関連しない生物学的合併症	26
3.2.1	オッセオインテグレーションの完全な喪失と咬合によるオーバーロード	26
3.2.2	オッセオインテグレーション喪失に関する他の病因論	27
3.2.3	プラークに関連しない口腔粘膜疾患	27
4章	ハードウェア関連合併症の原因と発生部位	29
	U. Brägger / (訳) 黒嶋伸一郎、澤瀬 隆	

4.1	材料と界面	30
4.2	運動エネルギーの吸収と生体力学的リスク	32
4.3	ハードウェア関連合併症と失敗	34
4.3.1	インプラント体	34
4.3.2	インプラント体/アバットメントの界面	34
4.3.3	アバットメントスクリュー	34
4.3.4	アバットメント	35
4.3.5	上部構造の維持：スクリュー固定とセメント固定	35
4.3.6	封鎖スクリュー、ヒーリングアバットメント、粘膜フォーマー	36
4.3.7	オーバードンチャーのアタッチメントシステム	36
4.3.8	中間構造体(メゾストラクチャー)	37
4.3.9	補綴装置	37
5 章	生物学的合併症への対処	39
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 今北千春、塩田 真	
5.1	インプラント周囲粘膜炎の治療	40
5.2	インプラント周囲炎の治療	42
5.2.1	術前段階	42
5.2.2	非外科的デブライドメント	43
5.2.3	早期再評価	44
5.2.4	外科的治療	44
5.2.5	術直後の管理	49
5.2.6	メンテナンス	49
5.2.7	インプラントの除去	49
5.2.8	まとめ	51
5.3	プラークに関連しない生物学的合併症	52
6 章	ハードウェア関連合併症への対処	53
	U. Brägger / (訳) 黒嶋伸一郎、澤瀬 隆	
6.1	ハードウェア関連合併症	54
6.1.1	インプラント体の破折と喪失	54
6.1.2	三次元的に好ましくないプラットフォームポジション	58
6.1.3	アバットメントに関連した合併症	61
6.1.4	アバットメントスクリューに関連した合併症	63
6.1.5	維持に関連した合併症	70
6.1.6	ヒーリングアバットメントに関連した合併症	78
6.1.7	オーバードンチャーのシステムに関連した合併症	80
6.2	上部構造に関連した合併症	83
6.2.1	義歯人工歯と義歯床	83
6.2.2	摩耗と咬耗	84

6.2.3	セラミックのチッピング	85
6.3	医原性の原因	86
7章	生物学的合併症の予防	89
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 藤井政樹、塩田 真	
7.1	インプラント周囲感染症の予防	90
7.1.1	治療計画	91
7.1.2	患者の準備	91
7.1.3	インプラント予定部位の準備	92
7.1.4	インプラントの埋入	93
7.1.5	補綴形態	95
7.1.6	サポーティブケア	98
7.1.7	インプラント周囲組織の診断のための経過観察	99
7.1.8	リコール頻度	100
7.2	咬合に起因するオーバーロードによるオッセオインテグレーションの喪失の予防	101
7.3	プラークに関連しない口腔粘膜疾患の予防	102
7.4	結論	103
8章	ハードウェア関連合併症の予防	105
	U. Brägger / (訳) 黒嶋伸一郎、澤瀬 隆	
8.1	コンポーネントと補綴装置に関連する合併症の予防	106
8.1.1	インプラント体	106
8.1.2	インプラント体とアバットメントの接合	106
8.1.3	アバットメントとアバットメントスクリュー	107
8.1.4	非純正コンポーネント	107
8.1.5	維持：スクリュー固定とセメント固定	108
8.1.6	封鎖スクリュー、ヒーリングアバットメント、粘膜フォーマー	109
8.1.7	オーバーデンチャーのアタッチメントシステム	109
8.1.8	中間構造体(メソストラクチャー)	110
8.1.9	上部構造	110
8.2	リスクマネージメント	111
9章	臨床ケース報告	115
	生物学的合併症	
9.1.1	補綴コンポーネントを交換して対応した医原性合併症：非外科的対応	116
	B. Schmid / (訳) 明石悠子、船越栄次	

9.1.2	アクセスフラップによるインプラント周囲炎の治療	120
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 明石悠子、船越栄次	
9.1.3	排膿を伴う瘻孔を形成した、余剰セメントに起因するインプラント周囲炎	123
	T. Linkevicius / (訳) 日高祥吾、船越栄次	
9.1.4	粘膜下の余剰セメントにより修飾されたインプラント周囲炎：再生療法と6年間のフォローアップ	127
	G. E. Salvi / (訳) 周藤 巧、船越栄次	
9.1.5	抗菌的ならびに再生アプローチにより治療したインプラント周囲炎	131
	A. Mombelli, P. Wick / (訳) 笹田雄也、船越栄次	
9.1.6	インプラント撤去に至った再発性インプラント周囲炎	134
	L. J. A. Heitz-Mayfield / (訳) 笹田雄也、船越栄次	

生物学的合併症(非感染性)

9.2.1	埋入位置が不良なインプラントの撤去とGBR法による同時カントゥアオーグメンテーションを伴う新たなインプラント埋入	136
	D. Buser, U. Belser / (訳) 武井宣暁、高尾康祐、船越栄次	
9.2.2	インプラント周囲粘膜の口腔扁平苔癬	147
	A. Frydrych / (訳) 柴戸和夏穂、船越栄次	
9.2.3	インプラント周囲のがん	149
	M. Moergel, P. W. Kämmerer, B. Al-Nawas / (訳) 柴戸和夏穂、船越栄次	
9.2.4	インプラント周囲組織の周辺性巨細胞肉芽腫	153
	M. M. Bornstein / (訳) 樋口 悠、船越栄次	
9.2.5	ビスフォスフォネート関連顎骨壊死につながったインプラント周囲炎	158
	M. M. Bornstein / (訳) 重永梨紗、船越栄次	
9.2.6	金属アレルギー	164
	D. Wismeijer, D. Kruger, J. Muris / (訳) 高尾康祐、船越栄次	

ハードウェア関連合併症

9.3.1	スクリュー固定式メタルセラミック補綴装置を支持するインプラントの破折への対処	167
	H. P. Weber, A. Grous / (訳) 北條正秋	
9.3.2	複数の生物学的および技工関連合併症が起きた患者の再治療	171
	S. Hicklin, S. Tettamanti, U. Brägger / (訳) 小林茉莉	
9.3.3	ジルコニアアバットメントの破折による技工関連合併症への対処	179
	T. Joda, U. Brägger / (訳) 小川雅子	
9.3.4	下顎の金属/アクリルレジン製インプラント支持固定性フルアーチ補綴装置のアクリルレジン部における繰り返しの破折	184
	J. Kan / (訳) 小林茉莉	

10章	インプラント支持補綴装置におけるハードウェア関連合併症の原因、対処、予防	189
	U. Brägger, S. Hicklin / (訳) 黒嶋伸一郎、澤瀬 隆	

11章	結論	197
	L. J. A. Heitz-Mayfield, U. Brägger / (訳) 船越栄次、高尾康祐	

12章	参考文献	199
------------	-------------------	------------